**专业培训记录**

**■QMS** **□50430****□EMS** **□OHSMS** **□EnMS** **□FSMS** **□HACCP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **重庆鼎信微电子有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **19.01.02** |
| **教师姓名** | **杨珍全** | **专业** | **19.01.02** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **余家龙** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | **生产/服务流程图：****电子料来料检验—AI/RI自动插件—SMT贴片加工—产品测试—包装—出货。****关键/确认过程：焊接过程，也是特殊过程。** |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制/** | **生产过程的风险：元器件选用不当，焊接不合格造成产品报废风险。****控制措施：制定操作指导书，人员技能培训，设备的维护保养等****特殊过程的控制：焊接过程为特殊过程，制定操作指导书，人员技能培训，设备的维护保养等并做好出厂检验。** |
| **重要环境及控制措施** | **/** |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | **/** |
| **重要的食品安全危害/关键控制点及控制措施** | **/** |
| 主要能源使用和主要能源参数等； | **/** |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | **相关法律法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法等、中华人民共和国安全生产法。****产品标准：电子组件可接受性IPC-A-610G；表面贴装设备性能检测方法IPC-9850等** |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | **产品的外观、元器件高度、焊接可靠性等** |
| **其它相关知识** | **无** |
| **填表人****(专业人员)** | 6f6c635d400c29486ef2a72372c844e | **日 期** | **2021.9.10** |
| **审核组长** | 6f6c635d400c29486ef2a72372c844e | **日 期** | **2021.9.10** |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**